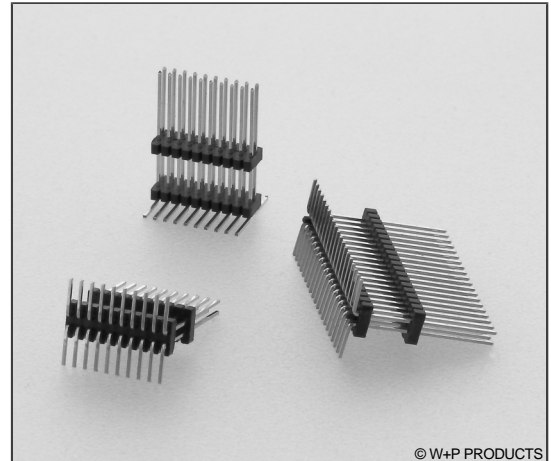


## SMT-Sandwich-Stiftleisten RM 1,00mm, 2-reihig SMT Dual Body Pin Headers, 1.00mm Pitch, Double Row

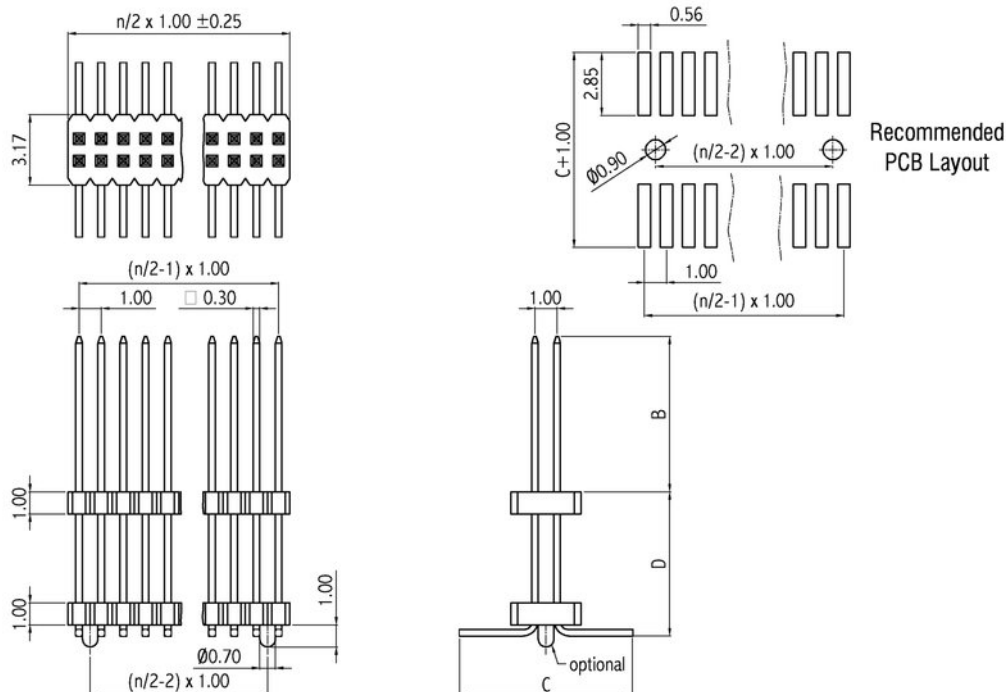
### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Vierkantstift 0,30mm, Kupferlegierung
Contact Material	0.30mm square pin, copper alloy
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
Contact Resistance	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 500MΩ
Insulation Resistance	> 500MΩ
Spannungsfestigkeit	500V <sub>AC</sub>
Test Voltage	500V <sub>AC</sub>
Nennstrom	1A
Current Rating	1A
Temperaturbereich	-40°C ... +105°C
Temperature Range	-40°C ... +105°C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
Processing	Reflow soldering



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:  
Compatible Female Headers:  
**7091**



<b>Series</b>	<b>Contacts*</b>	<b>Dimensions*</b>	<b>Plating*</b>	<b>Locating Pegs*</b>	<b>Packaging*</b>
<b>7058</b>	<b>016</b> 004-100 Zweireihig Double row	<b>10</b> B=7,00 C=7,80 D=6,50mm 99 Kundenspezifisch Customer-specific  (B+D = 18mm max.)	<b>00</b> Vergoldet Gold plated 50 Verzinkt Tin plated 60 Sel. Au/Sn Duplex plating	<b>10</b> 00 Ohne Pos.hilfen W/o loc. pegs 10 Mit Pos.hilfen (n/2 = gerade Zahl) With loc. pegs (n/2 = even number)	<b>PPST</b> ST PPST PPTR (Option)

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.

**Lieferformen / Packaging Options:**  
ST In Stangen ohne P&P-Pads / In tubes w/o P&P-Pads  
PPST In Stangen mit P&P-Pads / In tubes with P&P-Pads  
PPTR (Option) Tape & Reel mit P&P-Pads / Tape & Reel with P&P-Pads

# Informationen zum Reflow-Lötverfahren

## Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung

#### Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150°C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217°C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150°C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217°C
Duration above $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature $T_P$	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	Max. 8min

